

上海市锦天城律师事务所
关于上海伟测半导体科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的

补充法律意见书（二）



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

目 录

声明事项	2
释 义	4
正 文	6
第一部分 补充核查事项	6
一、 本次发行上市的批准和授权.....	6
二、 发行人本次发行上市的主体资格.....	6
三、 发行人本次发行上市的实质条件.....	6
四、 发行人的设立.....	11
五、 发行人的独立性.....	11
六、 发起人、股东及实际控制人.....	11
七、 发行人的股本及其演变.....	14
八、 发行人的业务.....	14
九、 关联交易及同业竞争.....	17
十、 发行人的主要财产.....	24
十一、 发行人的重大债权债务.....	29
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并.....	37
十三、 发行人公司章程的制定与修改.....	37
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	37
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化.....	38
十六、 发行人的税务.....	38
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	40
十八、 发行人募集资金的运用.....	41
十九、 发行人业务发展目标.....	41
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚.....	41
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价.....	41
二十二、 发行人律师认为需要说明的其他问题.....	42
二十三、 结论意见.....	43
第二部分 关于《第一轮问询函》相关回复的更新	44
问题 2.关于核心技术来源	44

上海市锦天城律师事务所
关于上海伟测半导体科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
补充法律意见书（二）

案号：01F20202132

致：上海伟测半导体科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“伟测科技”）的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次发行上市所涉有关事宜于 2021 年 12 月 22 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），并于 2022 年 2 月 28 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

本所律师根据发行人自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日期间（以下简称“补充核查期间”）已经存在或者发生的经营情况及事实情况，对发行人相关法律事项进行补充核查，现出具《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》

（以下简称“本补充法律意见书”）。本补充法律意见书是对《律师工作报告》、《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》的更新和补充，对于在《律师工作报告》、《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》中已经表述的部分，本补充法律意见书不再赘述。

声明事项

一、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及本所律师仅就与发行人本次发行上市有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预测等专业事项发表意见。在本补充法律意见书和为本次发行上市出具的《法律意见书》《律师工作报告》中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本补充法律意见书中，本所及本所律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件发生时所应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

四、本补充法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所为出具本补充法律意见书所要求发行人提供的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

六、本所同意发行人在《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》(以下简称“《招股说明书(申报稿)》”)中自行引用或按上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核要求引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

七、本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所律师根据有关法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。

释 义

本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

发行人、伟测科技、公司	指	上海伟测半导体科技股份有限公司
伟测有限	指	上海伟测半导体科技有限公司，发行人前身
蕊测半导体、控股股东	指	上海蕊测半导体科技有限公司，发行人股东
建泉元禾	指	江苏建泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
新潮投资	指	江苏新潮创新投资集团有限公司，发行人股东
德同合心	指	苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
子公司	指	发行人合并报表范围内的全资、控股子公司
南京伟测	指	南京伟测半导体科技有限公司，发行人子公司
本所、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
保荐机构、平安证券	指	平安证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	境内上市人民币普通股
本次发行上市、本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市
报告期	指	2019 年度、2020 年度及 2021 年度
补充核查期间	指	2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《招股说明书（申报稿）》	指	发行人为本次发行上市制作的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
《上市保荐书》	指	保荐机构出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》
《预计市值的分析报告》	指	保荐机构出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之预计市值的分析报告》
本补充法律意见书	指	《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》
《审计报告》	指	天健会计师出具的“天健审（2022）6-268 号”《上海伟测半导体科技股份有限公司三年期审计报告》
《内控鉴证报告》	指	天健会计师出具的“天健审（2022）6-269 号”《上海伟测半导体科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指发行人及其前身制定并不时修订的公司章程，另有说明的除外

《公司章程（草案）》	指	发行人为本次发行上市制定的《上海伟测半导体科技股份有限公司章程（草案）》，于 2021 年 10 月 8 日经发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过，于发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易之日起生效
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板首发管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《科创板股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
中国、境内	指	中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区），为本补充法律意见书之目的，指中国大陆地区
境外	指	除中国大陆地区以外的国家及地区
法律法规	指	提及当时公布并生效的中国大陆法律、行政法规、地方性法规、规章以及规范性文件
国家企业信用信息公示系统	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局主办的国家企业信用信息公示系统网站，其网址为 http://www.gsxt.gov.cn/
元、万元	指	人民币元、万元，上下文另有说明的除外

注：除特别说明外，本补充法律意见书中若出现总计数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

正 文

第一部分 补充核查事项

一、本次发行上市的批准和授权

本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露了发行人 2021 年第二次临时股东大会作出的批准本次发行上市以及授权董事会处理本次发行上市相关事宜的决议。截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行上市的批准和授权情况未发生变化。

二、发行人本次发行上市的主体资格

发行人为依法设立、有效存续且持续经营时间三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《科创板首发管理办法》第十条之规定，具备本次发行上市的主体资格，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未出现根据法律法规及《公司章程》需要终止的情形。

三、发行人本次发行上市的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本所律师认为，发行人符合股份有限公司公开发行新股及申请股票在科创板上市的相关实质条件：

（一）发行人本次发行上市符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件

1、发行人已就本次发行上市聘请了平安证券作为保荐机构，符合《证券法》第十条第一款的规定。

2、根据发行人本次发行的《招股说明书（申报稿）》及发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过之《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》，发行人本次发行的股票均为人民币普通股（A 股）股票，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，发行价格根据向询价对象询价结果并参考市场情况确定，不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十六条、一百二十七条的规定。

3、根据发行人 2021 年第二次临时股东大会会议文件，发行人本次发行已经依照《公司章程》的规定由股东大会和董事会对发行股票的种类、数量、价格、对象等事项作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

4、经本所律师查验，发行人已设立了股东大会、董事会、监事会及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，选举了董事（包括独立董事）、各董事会专门委员会委员、监事（包括职工代表监事），并聘请了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员，在报告期内发行人根据《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议，历次股东大会、董事会和监事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规以及当时适用的《公司章程》的规定，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规定。

5、发行人为长期存续的股份有限公司，其依照法律的规定在其经营范围内开展经营，截至本补充法律意见书出具之日，发行人依法有效存续，生产经营正常，具备生产经营所需的各项资质证书，能够支付到期债务，不存在影响其持续经营的法律障碍，具有持续经营能力。根据《审计报告》，发行人业务在报告期内有包括现金流量、营业收入、交易客户、管理费用支出等内容的持续营运记录；发行人不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项；亦不存在依据《公司法》及《公司章程》规定需要解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。

6、根据《审计报告》，发行人有关会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。天健会计师针对发行人最近三年一期的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

7、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认、公安机关出具的无犯罪记录证明、本所律师与实际控制人、发行人主要负责人的面谈及通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站的公开查询，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

（二）发行人本次发行上市符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件

1、经本所律师查验，发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，具备本次发行上市的主体资格，符合《科创板首发管理办法》第十条之规定。

2、根据《审计报告》及发行人的确认，并经本所律师访谈发行人财务总监，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由天健会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《科创板首发管理办法》第十一条第一款之规定。

3、根据《内控鉴证报告》及发行人的确认，并经本所律师查验，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由天健会计师出具了无保留结论的《内控鉴证报告》，符合《科创板首发管理办法》第十一条第二款之规定。

4、经本所律师查验，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款第（一）项之规定。

5、经本所律师查验，最近 2 年内发行人主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大不利变化，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款第（二）项之规定。

6、经本所律师查验，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等重大权属纠纷，发行人不存在重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。根据《招股说明书（申报稿）》及本所律师与发行人管理层的访谈，截至本补充法律意见书出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的经营环境已经或者将要发生重大变化并对发行人持续经营有重大不利影响，亦不存在其他对发行人持续经营有重大不利影响的事项，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》披露了相关风险因素，符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款第（三）项之规定。

7、根据《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明，发行人的主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。发行人及其子公司所从事的业务均在工商行政管理部门登记的经营范围内，发行人主营业务所属的行业亦为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2019 年修订）中的“鼓励类”产业。其经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策。经本所律师查验，发行人持有经营所需的各项资质证书，有关证书均在有效期内。经本所律师比对国家发展和改革委员会颁布之《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及中华人民共和国环境保护部颁布之《环境保护综合名录（2021 年版）》，发行人现有经营不涉及前述产业结构调整指导目录中列示的限制类和淘汰类产业，发行人现有产品不属于前述环境保护综合名录中列示的高污染、高环境风险产品，符合《科创板首发管理办法》第十三条第一款之规定。

8、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认，并经本所律师通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站进行公开查询，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《科创板首发管理办法》第十三条第二款之规定。

9、根据发行人的确认、发行人董事、监事及高级管理人员填写的调查表、作出的声明和承诺以及公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站的公开查询，发行人的现任董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《科创板首发管理办法》第十三条第三款之规定。

（三）发行人本次发行上市符合《科创板股票上市规则》规定的上市条件

1、如本补充法律意见书前文所述，发行人满足《科创板首发管理办法》第十条至第十三条规定的发行条件，符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项之规定。

2、根据发行人的历次验资报告以及发行人现时有效的《营业执照》，发行

人本次发行上市前股本总额为 6,540.80 万元，发行后股本总额不会低于 3,000 万元，符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项之规定。

3、根据经发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过之《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》及《招股说明书（申报稿）》，发行人本次发行前股份总数为 6,540.80 万股，发行人本次拟向社会公开发行的股份数不超过 2,180.27 万股，本次发行方案确定的拟发行股份数不低于发行后总股本的 25%，符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项之规定。

4、根据《上市保荐书》及《预计市值的分析报告》，发行人预计总市值不低于人民币 10 亿元，根据《审计报告》，发行人 2021 年度经审计的净利润为 132,175,641.77 元且营业收入为 493,144,257.09 元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元，发行人的市值及财务指标符合《科创板股票上市规则》第 2.1.2 条规定的第一项标准，发行人符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项之规定。

（四）发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）-（4）项之规定

1、根据《审计报告》，发行人 2019 年、2020 年、2021 年的研发费用分别为 13,371,662.77 元、21,013,963.09 元、47,742,834.01 元，占最近三年营业收入的比例分别为 17.16%、13.04%、9.68%，满足最近三年研发投入占营业收入比例 5% 以上的要求，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）项之规定。

2、根据《招股说明书（申报稿）》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司研发人员总数为 176 人，公司员工总数为 927 人，研发人员占当年公司员工总人数的比例为 18.99%，不低于 10%，因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（2）项之规定。

3、经本所律师查验有关专利证书以及本所律师通过国家知识产权局公开信息的查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司合法拥有 7 项形成主营业务收入的发明专利。因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（3）项之规定。

4、根据《审计报告》，发行人 2019 年、2020 年、2021 年的营业收入分别为 77,933,235.29 元、161,196,220.78 元、493,144,257.09 元，复合增长率超过 20%，

因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（4）项之规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行上市已经满足《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》规定的各项实质条件，尚需取得上交所的审核通过并经中国证监会同意注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

四、发行人的设立

本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露发行人的设立程序、条件等事项。经本所律师核查，补充核查期间，发行人的设立事宜未发生变化。

五、发行人的独立性

本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露发行人的独立性情况。根据发行人的说明并经本所律师核查，补充核查期间，发行人资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性未发生变化，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、发起人、股东及实际控制人

（一）发行人的发起人

经本所律师核查，补充核查期间，发行人的发起人未发生变化。发行人的发起人均具备向发行人出资、成为发起人股东的资格，发行人的发起人人数、住所和出资比例均符合有关法律法规的规定。

（二）发行人现有股东

经本所律师查验，补充核查期间，发行人共有 16 名股东，未发生变化，部分股东的相关信息发生变更，具体如下：

1、遑泉元禾

截至本法律意见书出具之日，遑泉元禾合伙人及合伙份额情况如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比例 (%)	合伙人类型
----	----------	-------------	---------------	-------

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比例 (%)	合伙人类型
1	苏州亚投荣基股权投资中心 (有限合伙)	80,000	24.3902	有限合伙人
2	苏州元禾控股股份有限公司	75,000	22.8658	有限合伙人
3	国家集成电路产业投资基金股份 有限公司	70,000	21.3415	有限合伙人
4	江苏省政府投资基金(有限合 伙)	45,000	13.7195	有限合伙人
5	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	20,000	6.0976	有限合伙人
6	苏州汾湖创新产业投资中心 (有限合伙)	20,000	6.0976	有限合伙人
7	长三角协同优势产业股权投资 合伙企业(有限合伙)	6,250	1.9055	有限合伙人
8	上海清恩资产管理合伙企业 (有限合伙)	4,375	1.3338	有限合伙人
9	上海科创中心二期私募投资基 金合伙企业(有限合伙)	4,375	1.3338	有限合伙人
10	苏州致芯方维投资管理合伙企 业(有限合伙)	3,000	0.9146	普通合伙人
合计		328,000	100	--

2、新潮投资

2021年9月29日，新潮投资的企业名称由“江苏新潮科技集团有限公司”变更为“江苏新潮创新投资集团有限公司”

3、德同合心

截至本法律意见书出具之日，德同合心合伙人及合伙份额情况如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例(%)	合伙人类型
1	西藏德同企业管理有限公司	5,000	2.5000	普通合伙人
2	上海科创中心一期股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	20,000	10.0000	有限合伙人
3	苏州市吴江产业投资有限公司	20,000	10.0000	有限合伙人
4	国投创合国家新兴产业创业投 资引导基金(有限合伙)	20,000	10.0000	有限合伙人
5	前海股权投资基金(有限合伙)	15,000	7.5000	有限合伙人
6	平潭坤盛鼎兴股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	8,400	4.2000	有限合伙人
7	江西省发展升级引导基金(有限	10,000	5.0000	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
	合伙)			
8	上海青浦投资有限公司	10,000	5.0000	有限合伙人
9	苏州工业园区元禾招商股权投资 投资基金合伙企业 (有限合伙)	10,000	5.0000	有限合伙人
10	上海世丞股权投资基金管理有 限公司	7,000	3.5000	有限合伙人
11	上海德心股权投资基金管理有 限公司	8,370	4.1850	有限合伙人
12	深圳市丰源昌意投资中心 (有限 合伙)	5,800	2.9000	有限合伙人
13	新余市晟创投资管理有限公司	7,000	3.5000	有限合伙人
14	远海明晟 (苏州) 股权投资合伙 企业 (有限合伙)	7,000	3.5000	有限合伙人
15	南通江海产业发展投资基金 (有 限合伙)	5,000	2.5000	有限合伙人
16	横琴宏帷股权投资基金合伙企 业 (有限合伙)	4,550	2.2750	有限合伙人
17	招商证券投资有限公司	5,000	2.5000	有限合伙人
18	嘉善县金融投资有限公司	5,000	2.5000	有限合伙人
19	苏州娄城国发高新技术产业投 资企业 (有限合伙)	3,000	1.5000	有限合伙人
20	上海灿辉投资发展有限公司	2,500	1.2500	有限合伙人
21	平阳箴言德同投资管理合伙企 业 (有限合伙)	2,000	1.0000	有限合伙人
22	辉县市豫辉哈工产业引导基金 合伙企业 (有限合伙)	2,000	1.0000	有限合伙人
23	共青城乾堃荣福投资合伙企业 (有限合伙)	3,250	1.6250	有限合伙人
24	北京京北时代投资中心 (有限合 伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
25	宁波京北未来成功投资中心 (有 限合伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
26	宁波海威同心股权投资中心 (有 限合伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
27	东渡丰汇投资发展集团有限公 司	1,000	0.5000	有限合伙人
28	惠州市润博信息咨询部 (有限合 伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
29	杭州易盛投资合伙企业 (有限合 伙)	1,000	0.5000	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
30	南昌辰景咨询管理有限公司	1,500	0.7500	有限合伙人
31	上海德槃资产管理有限公司	630	0.3150	有限合伙人
32	共青城函数厚颐投资管理合伙企业（有限合伙）	1,505	0.7525	有限合伙人
33	共青城函数泽源投资管理合伙企业（有限合伙）	1,495	0.7475	有限合伙人
34	深圳涵鑫六号投资中心（有限合伙）	3,000	1.5000	有限合伙人
合计		200,000	100	-

（三）发行人的控股股东和实际控制人

发行人的控股股东为蕊测半导体，骈文胜系发行人的实际控制人。补充核查期间，发行人的控股股东和实际控制人未发生变化。

七、发行人的股本及其演变

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人的股本及其演变。经本所律师核查，补充核查期间，发行人的股本及演变情况未发生变化。发行人各股东所持发行人的股份不存在冻结、质押等权利限制的情形。

八、发行人的业务

（一）发行人的经营范围和经营方式

1、发行人的经营范围

经本所律师查验，补充核查期间，发行人主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。与其《营业执照》所记载的经营范围相符，其经营范围和经营方式符合有关法律法规的规定。

2、发行人境内子公司的经营范围

经本所律师查验，补充核查期间，发行人新增一家全资子公司南京伟测，发行人及其子公司实际从事的业务没有超出其营业执照核准的经营范围，其经营范围和经营方式符合有关法律法规的规定。

（二）发行人及其子公司取得的资质、许可、备案文件

经本所律师查验，补充核查期间，发行人资质、许可、备案文件变化如下所示：

1、进出口相关证书文件

序号	持证主体	证书名称	登记机关	海关注册编码/ 登记备案表编号	登记日期
1	伟测科技	中华人民共和国海关 报关单位注册登记证 书	浦东海关	3122260CSL	2017-04-19
2	伟测科技	对外贸易经营者备案 登记表	上海市浦东新 区商务委员会	02725948	2021-01-13
3	无锡伟测	海关进出口货物收发 货人备案回执	无锡海关	32023631KN	2020-08-05
4	无锡伟测	对外贸易经营者备案 登记表	无锡市对外贸 易经济合作局	04184930	2020-07-31
5	南京伟测	海关进出口货物收发 货人备案回执	金陵海关	3201960JYX	2021-11-24

2、管理体系证书

序号	持证主体	证书类型	颁发机构	证书编号	证书内容	有效期限
1	伟测科技	质量管理 体系认证 证书	NOA Certificati on 挪亚检测	NOA16128 67	质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 标 准 认证范围：半导体芯 片测试	2021/08/23-20 22/08/15
2	伟测科技	环境管理 体系认证 证书	NOA Certificati on 挪亚检测	NOA16128 68	环境管理体系符合 GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准 认证范围：半导体芯 片测试	2021/08/23-20 22/08/15
3	伟测科技	职业健康 安全管理 体系认证 证书	NOA Certificati on 挪亚检测	NOA19947 51	职业健康安全管理体系符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 认证范围：半导体芯 片测试	2021/08/23-20 22/08/12
4	伟测科技	质量管理 体系认证 证书	Quality Austria 奥世认证	10515/0	质量管理体系符合 IATF 16949:2016 不含产品设计 半导体芯片的熔丝	2020/05/28-20 23/05/27

序号	持证主体	证书类型	颁发机构	证书编号	证书内容	有效期限
					微调	
5	无锡伟测	质量管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	25033/0	质量管理体系符合 ISO 9001:2015 集成电路芯片的熔丝微调 and 测试服务	2020/11/05-2023/11/04
6	无锡伟测	环境管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	04198/0	环境管理体系符合 ISO 14001:2015 集成电路芯片的熔丝微调 and 测试服务	2020/11/05-2023/11/04
7	无锡伟测	职业健康安全管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	00903/0	职业健康安全管理体系符合 ISO 4500:2018 集成电路芯片的熔丝微调 and 测试服务	2020/11/05-2023/11/04
8	无锡伟测	质量管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	12314/0	质量管理体系符合 IATF 16949:2016 不含产品设计 半导体芯片的熔丝微调	2021/11/03-2024/11/02

3、高新技术企业证书

2021 年 12 月发行人获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202131004437，有效期为 3 年。

（三）经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未在中国大陆以外的其他国家和地区从事经营活动。

（四）经本所律师查验，最近两年，发行人主营业务未发生变更。

（五）根据《审计报告》，报告期内发行人的营业收入以主营业务为主，发行人的主营业务突出。

（六）经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及子公司依照法律法规在其经营范围内开展经营，具备生产经营所需的各项资质证书或认证、备案文件，不存在影响其持续经营的法律障碍。根据《招股说明书（申报稿）》及发行人确认，截至本补充法律意见书出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的产业政策已经或者将要发生重大变化并对发行人持续

经营有重大不利影响的情形，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》披露了相关风险因素。

九、关联交易及同业竞争

（一）关联方

经本所律师查验，补充核查期间，发行人新增部分关联方，具体如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	南京伟测	发行人子公司
2	天津环球海洋工程装备有限公司	监事高晓配偶的弟弟担任执行董事的公司
3	天津环球水下系统作业装备有限公司	监事高晓配偶的弟弟担任执行董事的公司

（二）关联交易

根据《审计报告》、相关关联交易协议等文件，发行人及其子公司在报告期内与关联方发生的主要关联交易如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
强一半导体（苏州）有限公司	探针卡及维修	1,921,617.24	77,005.30	41,009.73
上海季丰电子股份有限公司	测试备件及服务	539,738.32	136,100.00	51,002.65
上海市浦东新区唐镇国澜餐饮店	餐饮		707,565.00	1,014,950.00
上海承括电子科技有限公司	速干墨水			24,180.00
江苏长电科技股份有限公司 [注]	测试设备	3,124,164.00		
小计		5,585,519.56	920,670.30	1,131,142.38

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体（江阴）有限公司合并披露，系关联公司

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
普冉半导体（上海）股份有限公司	检测服务及治具销售	16,240,233.51	17,977,381.34	9,969,172.49
中微半导体（深圳）股份有限公司	检测服务及治具销售	416,119.96	353,591.92	
江苏长电科技股份有限公司 [注]	检测服务	593,201.61	8,832,588.68	13,710,133.61
小计		17,249,555.08	27,163,561.94	23,679,306.10

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体（江阴）有限公司合并披露，系关联公司

2、关联租赁

（1）公司出租情况

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2021 年度确认的 租赁收入	2020 年度确认的 租赁收入	2019 年度确认的 租赁收入
江苏长电科技股份有限公司 [注]	检测设备	240,000.00	161,150.44	82,743.35

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体（江阴）有限公司合并披露，系关联公司

（2）公司承租情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度确认的 租赁费	2020 年度确认的 租赁费	2019 年度确认的 租赁费
江苏长电科技股份有限公司	检测设备	25,510,000.66	4,916,871.17	
上海季丰电子股份有限公司	检测设备		133,000.00	
小计		25,510,000.66	5,049,871.17	

3、关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
骈文	4,800,000.00	2021/3/12	2022/3/11	否	

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
胜、秦君梅	10,000,000.00	2021/4/22	2022/4/21		
	9,000,000.00	2021/1/15	2022/1/14		
	10,000,000.00	2021/9/26	2022/9/25		
骈文胜	35,000,000.00	2021/6/10	2023/6/9	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 66,969,204.43 元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	15,000,000.00	2021/11/18	2022/11/17	否	
	3,276,000.00	2021/6/7	2024/6/7		
	6,724,000.00	2021/9/6	2024/6/7		
	10,000,000.00	2021/6/11	2022/5/30		
骈文胜	6,790,902.59	2020/12/15	2023/12/15	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 42,084,074.37 元的固定资产提供抵押担保
	9,172,507.07	2021/1/12	2023/12/15		
	10,100,530.96	2021/2/9	2023/12/15		
	10,271,961.11	2021/6/3	2024/5/20		
骈文胜	429,905.13	2019/12/5	2022/1/14	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 5,825,637.88 元的使用权资产提供抵押担保
	1,375,213.88	2019/12/17	2022/2/13		
	970,963.80	2019/12/17	2022/12/2		
	976,932.17	2020/2/28	2023/2/1		
骈文胜、秦君梅、上海蕊测半导体科技有限公司	3,534,802.02	2020/5/27	2023/5/12	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 23,517,038.99 元的使用权资产提供抵押担保
	4,211,125.99	2020/8/14	2023/8/14		
	3,755,352.42	2020/8/14	2023/8/29		
	1,164,085.47	2020/9/3	2023/9/28		
	3,046,366.10	2020/11/3	2023/11/16		
	1,959,675.27	2020/11/3	2023/11/16		
骈文胜	1,108,286.15	2019/7/31	2022/7/16	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 9,838,859.35 元的固定资产提供抵押担保
	1,306,907.47	2019/9/30	2022/9/14		
骈文胜、闻国涛	2,255,385.35	2019/4/22	2022/4/22	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 26,637,711.37 元的使用权资产提供抵押担保
	8,033,963.02	2021/3/22	2023/3/22		
骈文胜、闻国涛、上海蕊测半导体科技	1,268,494.42	2019/8/10	2022/8/10	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 14,405,440.11 元的使用权资产提供抵押担保
	2,469,104.02	2019/9/22	2022/9/21		

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
有限公司					
骈文胜、秦君梅	3,749,999.95	2020/9/29	2022/9/21	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为12,981,643.50元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	21,818,181.81	2020/11/17	2023/11/16	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为37,986,749.70元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	1,839,356.74	2021/5/27	2024/5/27	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为13,396,302.23元的使用权资产提供抵押担保
	7,827,033.60	2021/7/9	2024/7/9		
骈文胜、闻国涛、路峰	12,985,558.28	2020/10/23	2023/10/22	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为3,464,506.10元固定资产及24,365,381.69元的使用权资产提供抵押担保
骈文胜、闻国涛	6,327,219.75	2021/2/22	2023/2/22	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为12,436,316.78元的使用权资产提供抵押担保
上海蕊测半导体科技有限公司	5,039,297.01	2021/6/29	2024/6/29	否	
	12,545,230.19	2021/6/30	2024/6/30		
	10,591,878.94	2021/6/30	2024/6/30		
骈文胜、上海蕊测半导体科技有限公司	12,825,834.31	2021/7/29	2023/6/29	否	
	9,669,940.25	2021/8/23	2023/7/23		
骈文胜、闻国涛	9,833,254.54	2020/10/23	2022/10/21	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为33,941,258.89元的使用权资产提供抵押担保
骈文胜	130,194,359.32	2021/8/3	2026/8/2	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为97,381,953.99元的固定资产以及账面价值为7,855,953.57元的无形资产提供抵押担保

4、关联方资金拆借

（1）2021年度

无。

(2) 2020 年度

单位：元

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆出					
骈文胜	300,000.00		300,000.00		
路峰	150,000.00		150,000.00		
小计	450,000.00		450,000.00		

(3) 2019 年度

单位：元

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆入					
上海蕊测半导体科技有限公司	2,999,400.00	1,598,269.00	4,597,669.00		675,291.93
龚金新	200,000.00		200,000.00		15,696.44
路峰	1,380,000.00		1,380,000.00		108,115.28
秦君梅	1,000,000.00		1,000,000.00		78,344.40
小计	5,579,400.00	1,598,269.00	7,177,669.00		877,448.05
拆出					
路峰		150,000.00		150,000.00	
闻国涛	100,000.00	1,050,000.00	1,150,000.00		
骈文胜	333,500.00	580,000.00	613,500.00	300,000.00	
小计	433,500.00	1,780,000.00	1,763,500.00	450,000.00	

5、关键管理人员报酬

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	5,533,372.35 元	2,187,779.24 元	1,534,605.84 元

(三) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款							
	普冉半导体（上海）股份有限公司	2,348,048.51	117,402.43	8,134,702.58	406,735.13	4,695,590.43	234,779.52
	中微半导体（深圳）股份有限公司	93,004.81	4,650.24	111,041.35	5,552.07		
	江苏长电科技股份有限公司	90,365.51	4,518.28	189,693.86	9,484.69	1,886,532.31	94,326.62
	江阴长电先进封装有限公司			135,600.00	6,780.00		
	星科金朋半导体（江阴）有限公司			20,826.15	1,041.31	2,223,852.55	111,192.63
小计		2,531,418.83	126,570.95	8,591,863.94	429,593.20	8,805,975.29	440,298.77
其他应收款							
	骈文胜					304,952.10	15,247.61
	路峰					150,000.00	7,500.00
	乔从缓					3,552.00	177.60
	周歆瑶					18,569.00	928.45
小计						477,073.10	23,853.66

2、应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付账款				
	星科金朋半导体（江阴）有限公司	870,000.00	972,545.98	

项目名称	关联方	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
	江阴长电先进封装有限公司		1,858,319.35	
	江苏长电科技股份有限公司		1,667,639.86	
	强一半导体（苏州）有限公司	1,547,400.48	46,796.00	29,925.00
	上海季丰电子股份有限公司	24,374.10	97,858.00	
	上海承括电子科技有限公司			8,814.00
小计		2,441,774.58	4,643,159.19	38,739.00
其他应付款				
	上海蕊测半导体科技有限公司	1,300.00	1,300.00	676,591.95
	闻国涛			900.00
	龚金新			87,696.44
	路峰			108,115.28
	秦君梅			78,344.40
小计		1,300.00	1,300.00	951,648.07

（四）发行人的关联交易决策程序

经本所律师查验，针对补充核查期间新增的关联交易，发行人履行了如下决策程序：

1、发行人第一届董事会第十二次会议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

2、发行人独立董事对于《关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见及独立意见，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，遵循自愿、有偿和公平的商业原则，履行了相关决策程序，关联董事已按规定回避表决，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

据此，本所律师认为，补充核查期间，发行人已制定的关联交易的决策程序得到有效执行，保护了发行人及股东的利益。

（五）同业竞争

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。为有效防止及避免同业竞争，发行人控股股东蕊测半导体、实际控制人

骈文胜已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

综上所述，本所律师认为，发行人报告期内不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；发行人已在《公司章程》《公司章程（草案）》及其内部制度中规定了关联交易的决策程序；截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

十、发行人的主要财产

（一）不动产权及租赁使用权

1、自有不动产权

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的不动产权未发生变化。

2、不动产租赁使用权

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司的主要租赁使用权情况更新如下：

序号	出租方	承租方	租赁坐落	租赁用途	面积	租赁期间
1	上海新发创运置业有限公司	伟测科技	上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 幢	生产	1,984.89 m ²	2019/03/30-2024/03/29
2	上海新发创运置业有限公司	伟测科技	上海市浦东新区胜利路 188 号 D 区 1 幢	生产、办公	3,704.43 m ²	2021/03/01-2031/02/28
3	无锡星洲工业园区开发股份有限公司	无锡伟测	无锡新加坡工业园 301 地块 503 号厂房	办公	7,875.65 m ² /12,751.29m ²	2021/06/01-2026/05/31
4	南京天弘源资产管理有限公司	南京伟测	南京市浦口经济开发区双浦路 77 号辉瑞控股南京智能装备产业园 A4 栋防火分区 5	生产、办公	5,195.5 m ²	2021/12/01-2026/11/30

（二）发行人拥有的知识产权

1、商标

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司所拥有的商标未发生变化。

2、专利

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司所拥有的专利情况更新如下：

序号	专利申请名称	类型	取得方式	申请号/专利号	权利期限	专利权人	他项权利
1	晶圆区域性问题的分析系统及方法	发明专利	原始取得	202110310750.9	2021/03/24-2041/03/23	伟测科技	无
2	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法	发明专利	专利转让	202110248636.8	2021/03/08-2041/03/07	无锡伟测	
3	一种测试机匹配检测系统及其方法	发明专利	原始取得	202011533224.0	2020/12/23-2040/12/22	伟测科技	
4	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统	发明专利	原始取得	202011523844.6	2020/12/22-2040/12/21	伟测科技	
5	一种多平台联动提效机构	发明专利	原始取得	202011489734.2	2020/12/17-2040/12/16	伟测科技	
6	一种集成电路精确测试小电阻的方法	发明专利	原始取得	202011160294.6	2020/10/27-2040/10/26	伟测科技	
7	腐蚀粉在整形铂金探针的应用和铂金探针的整形方法	发明专利	原始取得	202110234659.3	2021/03/03-2041/03/02	伟测科技	
8	一种 Chroma Q-type 转接板开路断路检验装置	实用新型	原始取得	202120877907.1	2021/04/26-2031/04/25	无锡伟测	
9	一种子母式探针卡装配结构	实用新型	原始取得	202120864029.X	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
10	一种延长墨管使用寿命的装置	实用新型	原始取得	202120868460.1	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
11	一种防止测试载板结霜的装置	实用新型	原始取得	202120866185.X	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
12	一种方便操作的便携式有线线缆检测机构	实用新型	原始取得	202120554510.9	2021/03/18-2031/03/17	无锡伟测	
13	一种探针卡针延长寿命用的垫座	实用新型	原始取得	202120556145.5	2021/03/18-2031/03/17	无锡伟测	
14	一种芯片测试机上的真空除尘结构	实用新型	原始取得	201721787488.2	2017/12/20-2027/12/19	伟测科技	

序号	专利申请名称	类型	取得方式	申请号/专利号	权利期限	专利权人	他项权利
15	一种防止集成电路针测扎偏的装置	实用新型	原始取得	201721787486.3	2017/12/20-2027/12/19	伟测科技	
16	一种芯片测试机的翻转机构	实用新型	原始取得	201721787489.7	2017/12/20-2027/12/19	伟测科技	
17	一种电路板测试装置	实用新型	原始取得	201721231664.4	2017/09/25-2027/09/25	伟测科技	
18	一种真空吸附检测台的承载平台	实用新型	专利转让	201721231321.8	2017/09/25-2027/09/24	无锡伟测	
19	一种可以提高打点产品效率的模具	实用新型	专利转让	201721231323.7	2017/09/25-2027/09/24	无锡伟测	
20	一种自动油墨打点器	实用新型	专利转让	201721231624.X	2017/09/25-2027/09/24	无锡伟测	
21	一种自动降温器	实用新型	原始取得	201721231457.9	2017/09/25-2027/09/24	伟测科技	
22	一种利用工业空调冷却水实现测试机冷循环装置	实用新型	原始取得	201720068187.8	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
23	一种背银、背金晶圆测试稳压装置	实用新型	原始取得	201720068189.7	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
24	一种易于安装的晶圆测试装置	实用新型	原始取得	201720068329.0	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
25	一种抗干扰晶圆测试机外壳	实用新型	原始取得	201720068188.2	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
26	一种探针卡拆卸防呆装置	实用新型	原始取得	202120870208.4	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
27	一种集成电路检测设备	实用新型	原始取得	202121569857.7	2021/07/09-2031/07/08	无锡伟测	
28	料盘翘曲平整装置	实用新型	原始取得	202121715058.6	2021/07/26-2031/07/25	无锡伟测	
29	一种用于半导体自动分选机快速降温装置	实用新型	原始取得	202121422099.6	2021/06/24-2031/06/23	无锡伟测	

注：无锡伟测通过“专利转让”获得的1项发明专利和3项实用新型专利系从发行人处受让取得，转让过程合法、有效，并已在国家知识产权局备案。

3、许可专利使用权情况

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的专利许可使用权情况更新如下所示：

序号	名称	专利号	类型	授权公告日	发明人	权利人
1	一种晶元芯片检测工装	201521040030.1	实用新型	2016/05/11	邹磊	普镭电子（上海）有限公司

序号	名称	专利号	类型	授权公告日	发明人	权利人
2	一种晶元自动检测设备用探针定位夹具	201521035597.X	实用新型	2016/05/11	杨会会	普钰电子（上海）有限公司
3	一种探针安装座	201521035631.3	实用新型	2016/05/11	张旆	普钰电子（上海）有限公司
4	一种简易探针固定座	201521035633.2	实用新型	2016/05/11	邹磊	普钰电子（上海）有限公司
5	一种晶元芯片检测头结构	201521035528.9	实用新型	2016/05/11	邹磊	普钰电子（上海）有限公司
6	一种晶元芯片检测头组件	201521035600.8	实用新型	2016/05/11	杨会会	普钰电子（上海）有限公司
7	一种晶元片检测头结构	201620794181.4	实用新型	2017/03/15	范秋萍	普钰电子（上海）有限公司
8	一种调节式晶元片检测头组件	201620794239.5	实用新型	2017/01/25	何佳	普钰电子（上海）有限公司
9	一种基于探针的检测头组件	201620794220.0	实用新型	2017/01/25	郑清林	普钰电子（上海）有限公司
10	一种稳定型晶元片检测头组件	201620794217.9	实用新型	2017/01/25	周莲国	普钰电子（上海）有限公司
11	一种基于晶元片检测的集成式检测头组件	201820211613.3	实用新型	2018/09/25	杨明亮	普钰电子（上海）有限公司
12	一种组合式晶元片检测头组件	201820211657.6	实用新型	2018/09/25	洪家萍	普钰电子（上海）有限公司

4、集成电路布图设计

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的集成电路布图设计情况未发生变化。

5、计算机软件著作权

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权情况更新如下：

序号	证书编号	软件名称	取得方式	著作权人	首次发表日期	权利期限
1	软著登字第2042850号	伟测自动测试报告系统	原始取得	伟测科技	2017/06/05	50年
2	软著登字第8590308号	伟测TEL型号探针台的晶圆图转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50年

序号	证书编号	软件名称	取得方式	著作权人	首次发表日期	权利期限
3	软著登字第8672298号	伟测 TXT&Excel 与晶圆&Bin 坐标对比软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50 年
4	软著登字第8672285号	伟测测试机 STDF 大文件压缩转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50 年
5	软著登字第9043690号	伟测测试机 CSV 文件到 TSK 探针台的晶圆图转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50 年
6	软著登字第9248208号	伟测测试机 XML/TXT 文件探针台的 MAP 图转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50 年

6、域名

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的域名情况未发生变化。

（三）发行人拥有的生产经营设备

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的主要生产经营设备为专用设备及办公设备，该等设备均由发行人实际占有和使用，均通过合法途径取得，主要经营设备不存在产权纠纷或争议。

（四）发行人拥有的出资权益或股权

经本所律师查验，补充核查期间，发行人新增一家子公司南京伟测，截至本补充法律意见书出具之日，南京伟测的基本情况如下所示：

企业名称	南京伟测半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91320111MA2798JE32
法定代表人	骈文胜
住所	南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 C-93
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	7,000 万元人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2021-10-21 至无固定期限

经本所律师查验，发行人的上述财产均通过合法途径取得，截至本补充法

律意见书出具之日，上述财产不存在产权纠纷，不存在权利受到限制的情形。

十一、发行人的重大债权债务

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的重大债权债务更新情况如下所示：

（一）重大合同

1、重大销售合同

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已签订的正在履行的重大销售合同更新如下：

序号	客户名称	合同标的	形式	签订日期	履行情况
1	客户 A	集成电路测试服务	框架合同	2020/10/12	正在履行
2	晶晨半导体（上海）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021/1/2	正在履行
3	深圳市中兴微电子技术有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2017/12/20	正在履行
4	上海安路信息科技股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2020/2/1	正在履行
5	普冉半导体（上海）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021/5/11	正在履行
6	Bitmain Technologies Limited（比特大陆）	集成电路测试服务	框架合同	2021/4/1	正在履行
7	江苏长电科技股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2020/3/2	正在履行
8	上海复旦微电子集团股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2018/6/6	正在履行
9	甬矽电子（宁波）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021/10/9	正在履行
10	北京兆易创新科技股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2020/4/17	正在履行

2、重大采购合同

发行人报告期内已签订的正在履行或履行完毕的金额在 100 万美元以上的或 1,000 万人民币以上的重大采购订单以及重大的采购框架协议为公司的重大采购合同，更新情况如下：

序号	供应商名称	合同标的	币别	金额（万元）	签订日期	履行情况
1	致茂电子股份有限公司	集成电路测试机	USD	390.00	2021/6/4	正在履行
		集成电路测试机	USD	455.00	2020/3/16	正在履行

序号	供应商名称	合同标的	币别	金额（万元）	签订日期	履行情况
		集成电路测试机	USD	399.00	2019/6/5	正在履行
		集成电路测试机	USD	130.00	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	75.00	2020/12/30	履行完毕
		集成电路测试机	USD	65.00	2020/12/30	履行完毕
		集成电路测试机	USD	65.00	2020/11/30	履行完毕
2	先域微电子技术 服务（上海）有限 公司	高速转塔测试机	RMB	1,459.19	2020/11/19	正在履行
3	ADVANTEST CORPORATION	集成电路测试机	-	框架合同	2021/6/29	正在履行
4	Teradyne（Asia） Pte.Ltd	集成电路测试机	USD	23.80	2020/8/28	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	22.80	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	160.40	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	89.00	2020/12/23	履行完毕
		集成电路测试机	USD	44.50	2020/12/24	履行完毕
		集成电路测试机	USD	89.00	2020/8/10	履行完毕
		测试机、设备板 卡及备件	USD	94.20	2020/8/21	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	2.70	2021/5/18	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	29.80	2021/4/16	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	29.80	2021/5/9	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	27.23	2021/5/20	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	7.78	2021/6/1	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	56.00	2021/10/20	履行完毕
		集成电路测试机	USD	303.90	2021/9/29	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	104.10	2021/7/15	履行完毕
		集成电路测试机	USD	133.50	2021/10/22	履行完毕
		集成电路测试机	USD	133.50	2021/11/4	履行完毕
		集成电路测试机	USD	133.50	2021/11/27	履行完毕
5	Semics.Inc	自动探针台	USD	530.00	2019/12/3	履行完毕
		探针台	USD	102.00	2020/9/15	履行完毕
		探针台	USD	51.00	2021/3/11	履行完毕
		探针台	USD	153.00	2021/3/11	履行完毕
		探针台	USD	20.40	2021/3/11	履行完毕
		其他周转材料	USD	0.24	2021/3/22	履行完毕

序号	供应商名称	合同标的	币别	金额（万元）	签订日期	履行情况
		探针台	USD	20.40	2021/4/26	履行完毕
		探针台	USD	397.00	2021/6/23	履行完毕
		探针台	USD	241.10	2021/7/2	履行完毕
		其他周转材料	USD	30.60	2021/7/1	履行完毕
6	Tokyo Seimitsu Co., Ltd	探针台	JPY	16,600.00	2020/8/25	履行完毕
		探针台	JPY	49,305.00	2021/6/19	正在履行
7	天津金海通自动化设备股份有限公司	集成电路测试机	-	框架协议	2020/11/30	正在履行
8	鸿劲精密股份有限公司	分选机	USD	160.00	2021/6/10	履行完毕
		分选机	USD	160.00	2021/6/10	履行完毕
		分选机	USD	204.00	2021/5/25	履行完毕
		分选机	USD	67.50	2021/7/7	履行完毕
9	上海午盛实业有限公司	厂务设备及工程	RMB	2,700.00	2021/7/7	履行完毕

经本所律师查验，发行人上述重大采购和销售合同合法有效，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未发生与上述合同相关的重大纠纷或争议。

3、重大借款合同及担保合同

经本所律师查验，发行人报告期内已签订正在履行或履行完毕的合同金额超过 500 万元更新如下：

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保（抵押）合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额（万元）	履行情况
1	Z2005LN15676636	交通银行股份有限公司上海浦东新区支行	保证合同（C200514GR3109480）	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/6/1	2021/5/27	RMB	800.00	履行完毕
2	Z2007LN15624919		保证合同、抵押担保（C190311MG3107572、C200514GR3109480、JTYH00220200101202）	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保、上海市中小微企业政策性融资担保基金管	2020/8/11	2021/7/16	RMB	950.00	履行完毕

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保（抵押）合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额（万元）	履行情况
			01231)	理中心提供担保					
3	Z2108LN15614930		-	-	2021/8/24	2022/8/24	RMB	3,000.00	履行完毕
4	97162020280206	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	最高额保证合同 ZB9716202000000027	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/6/23	2021/6/22	RMB	500.00	履行完毕
5	97162020280312		最高额保证合同 ZB9716202000000027	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/9/9	2021/9/8	RMB	500.00	履行完毕
6	97162021280289		最高额保证合同 ZB9716202000000027	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/9/26	2022/9/25	RMB	1,000.00	正在履行
7	97162021280114		最高额保证合同 (ZB9716202000000027)	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/4/22	2022/4/21	RMB	1,000.00	正在履行
8	平银沪科创贷字20210111第001号	平安银行上海分行营业部	最高额保证担保合同【平银沪科创额保字20210111第001号、002号】	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/1/15	2022/1/14	RMB	900.00	履行完毕
9	Z2105LN15651734	交通银行股份有限公司上海新区支行	保证合同(C200514GR3109480)	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/6/11	2022/5/30	RMB	1,000.00	正在履行
10	CL202012003	浦发硅谷银行有限	CL20201202-PG、CL20201203-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器	2020/12/15	2023/12/15	USD	159.77	正在履行

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保（抵押）合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额（万元）	履行情况
		公司		设备抵押					
11	CL202012003		CL20201202-PG、CL20201203-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2021/1/12	2023/12/15	USD	215.80	正在履行
12	CL202012003		CL20201202-PG、CL20201203-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2021/2/9	2023/12/15	USD	224.43	正在履行
13	CL202105002		CL20210502-EM	机器设备抵押	2021/6/3	2024/5/20	USD	200.00	正在履行
14	公授信字第02702021213200号	中国民生银行股份有限公司上海分行	最高额保证合同（公高保字第02702021213201号）、最高额抵押合同：公高抵字第0270202021213202号、公高抵字第02702021213204号	骈文胜最高额不可撤销担保	2021/6/10	2023/6/9	RMB	3,500.00	正在履行
15	121XY2021032339	招商银行股份有限公司上海分行	最高额不可撤销担保书（121XY2021032339）	骈文胜最高额不可撤销担保	2021/11/18	2022/11/17	RMB	1,500.00	正在履行
16	2021082601	招商银行股份有限公司无锡分行	最高额抵押合同（202108260104）、抵押合同（202108260103）	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2021/8/3	2026/8/2	RMB	15,000.00	正在履行

4、融资租赁合同

经本所律师查验，发行人报告期内已签订的正在履行或履行完毕的融资租赁合同更新如下：

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
(一) 上海伟测半导体科技股份有限公司						
1	北亚融资租赁 (上海)有限公司	设备融资租赁合同 NAFL201629-12 补充协议 NAFL20170102	95,108.00 元	2017/1/17	24 个月	履行完毕
2		设备融资租赁合同 NAFL2017032-05	45,425.92 美元	2017/5/31	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017032-05 补充协议 NAFL20170801	12,310.84 美元	2017/8/10	24 个月	履行完毕
3		设备融资租赁合同 NAFL2017046-07 (第一批)	35,270.81 美元	2017/7/31	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017046-07 (第二批)	60,371.38 美元	2017/7/31	24 个月	履行完毕
4		设备融资租赁合同 NAFL2017056-09	20,328.41 美元	2017/9/20	24 个月	履行完毕
5		设备融资租赁合同 NAFL2017066-11	529,201.16 元	2017/12/11	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017066-11 补充协议 NAFL20180201	128,742.81 元	2018/2/10	24 个月	履行完毕
6		设备融资租赁合同 NAFL2018013-05	467,057.00 元	2018/5/8	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2018013-05-02	334,590.22 元	2018/5/18	36 个月	履行完毕
7		设备融资租赁合同 NAFL2018026-07	350,537.88 元	2018/7/9	36 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2018026-07 补充协议 NAFL20180810	30,431.49 元	2018/8/10	36 个月	履行完毕
8		设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 (第一批)	42,896.99 元	2018/9/21	36 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 (第二批)	23,035.83 元	2018/9/21	36 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 补充协议 NAFL20181217	177,896.88 元	2018/12/10	36 个月	履行完毕
9		设备融资租赁合同 NAFL2019007-04	565,060.29 元	2019/5/5	36 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2019007-04	289,719.82 元	2019/6/10	36 个月	履行完毕
10		设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 (第一批)	163,136.11 元	2019/8/23	36 个月	正在履行
		设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 (第二批)	283,145.52 元	2019/8/23	36 个月	正在履行
		设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 补充协议 NAFL20191015	133,461.81 元	2019/10/10	36 个月	履行完毕

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
		设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 补充协议 NAFL20191101	142,305.81 元	2019/11/10	24 个月	履行完毕
11		设备融资租赁合同 NAFL2019030-11	499,195.28 元	2019/11/19	24 个月	履行完毕
12		设备融资租赁合同 NAFL2020034-02 设备融资租赁合同 NAFL2020034-02 补充协议 NAFL20200415001	638,955.70 元 279,593.69 元	2020/2/20 2020/4/21	24 个月 24 个月	履行完毕 履行完毕
13		设备融资租赁合同 NAFL2021047-02	556,554.15 元	2021/3/26	24 个月	正在履行
14	浦银金融租赁股份有限公司	融资租赁合同（售后回租类） PYHZ0120200030	416,666.67 元	2020/9/29	24 个月	正在履行
15	交银金融租赁有限责任公司	融资租赁合同（回租）交银租赁字 【20190213】号	398,355.13 元	2019/12/26	24 个月	履行完毕
16	芯鑫融资租赁有限责任公司	售后回租赁合同 SINOICL2020D08Y002-L-01	4,583,999.65 元	2020/3/31	36 个月	履行完毕
17	中电投融和融资租赁有限公司	融资租赁合同（售后回租） RHZL-2020-101-1382-SHWCBTD-001	2,727,272.73 元	2020/11/10	36 个月	正在履行
18	仲利国际租赁有限公司	融资租赁合同 AA18100338AKX	140,625 元	2018/10/12	24 个月	履行完毕
19	苏州融华租赁有限公司	融资租赁合同 RH-L-2019009-1	162,469.75 元	2019/6/6	36 个月	正在履行
20		融资租赁合同 RH-L-2019009-2	149,972.10 元	2019/8/15	36 个月	正在履行
21		融资租赁合同 RH-L-2019023-1	37,287.45 元	2019/12/2	36 个月	正在履行
22		融资租赁合同 RH-L-2019023-2	119,278.00 元	2019/12/17	36 个月	正在履行
23		融资租赁合同 RH-L-2019023-3	84,216.00 元	2019/12/20	36 个月	正在履行
24		融资租赁合同 RH-L-2019023-4	72,669.00 元	2020/2/25	36 个月	正在履行
25		融资租赁合同 RH-L-2020003-1	7,757,856 元	2020/5/25	36 个月	正在履行
26		补充协议 RH-L-2020003-1/S01	216,978.00 元	2020/6/12	36 个月	正在履行
27		融资租赁合同 RH-L-2020003-2	140,162.00 元	2020/7/25	36 个月	正在履行
28		补充协议 RH-L-2020003-3/S01	223,014.00 元	2020/9/3	36 个月	正在履行

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
29		融资租赁合同 RH-L-2020003-4	90,976.00 元	2020/8/31	36 个月	正在履行
30		融资租赁合同 RH-L-2020003-5	199,026.00 元	2020/8/27	36 个月	正在履行
31		补充协议 RH-L-2020003-5/S01	198,877.00 元	2020/10/20	36 个月	正在履行
32		融资租赁合同 RH-L-2020003-6	2,170,152.00 元	2020/9/3	36 个月	正在履行
33		补充协议 RH-L-2020003-6/S01	58,871.00 元	2020/10/20	36 个月	正在履行
34	海通恒 信国际 融资租 赁股份 有限公 司	融资租赁合同 L21A0441003	68,283.60 元	2021/4/26	36 个月	正在履行
35		融资租赁合同 L21A0441004	273,134.40 元	2021/4/26	36 个月	正在履行
(二) 无锡伟测半导体科技有限公司						
1	北亚融 资租赁 (上 海)有 限公司	设备融资租赁合同 NAFL2020042-10	1,018,064.88 元	2020/10/23	24 个月	正在履行
2		设备融资租赁合同 NAFL2021046-02	468,512.94 元	2021/2/22	24 个月	正在履行
3	诚泰融 资租赁 (上 海)有 限公司	融资租赁合同 CHTDCS4355-C001-L01	620,607.52 元	2020/10/23	36 个月	正在履行
4	平安国 际融资 租赁有 限公司	融资租赁合同 2021PAZL0101129-ZL-01	177,204.70 元	2021/6/8	36 个月	正在履行
5		融资租赁合同 2021PAZL0101132-ZL-01	441,147.60 元	2021/6/30	36 个月	正在履行
6		融资租赁合同 2021PAZL0101133-ZL-01	372,458.85 元	2021/6/30	36 个月	正在履行
7	远东国 际融资 租赁有 限公司	融资租赁合同 IFELC21DG1FCBW-L-01	755,028.01 元	2021/6/27	24 个月	正在履行
8		融资租赁合同 IFELC21DG1USW5-L-01	540,907.32 元	2021/7/15	24 个月	正在履行
9	苏州融 华租赁 有限公 司	融资租赁合同 RH-L-2021009-1	302,372.00 元	2021/4/9	36 个月	正在履行

注：苏州融华租赁有限公司的《融资租赁合同 RH-L-2019009-1》、《融资租赁合同 RH-L-2019009-2》为售后回租。

5、其他重大合同

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人其他重大合同未发生变化。

（二）经发行人说明并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）根据《审计报告》并经本所律师查验，截至报告期末，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系。

（四）根据《审计报告》并经本所律师查验，截至报告期末，发行人存在关联方为其提供担保的情形，具体情况详见本补充法律意见书“九、关联交易及同业竞争”之“（二）关联交易”，发行人不存在为关联方提供担保的情形。

（五）经本所律师查验，截至报告期末，发行人金额较大的其他应收款以及其他应付款均系发行人正常生产经营而发生的往来款，合法有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）经本所律师查验，补充核查期间，发行人不存在合并、分立、增加或者减少注册资本的行为。

（二）经本所律师查验，补充核查期间，发行人不存在重大资产变化、收购或出售资产行为。

（三）根据发行人的确认并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为。

十三、发行人公司章程的制定与修改

经本所律师查验，补充核查期间，发行人《公司章程》未发生变化，发行人现行的《公司章程》及《公司章程（草案）》均符合现行法律法规的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）经本所律师查验，补充核查期间，发行人的组织机构未发生变化。

（二）经本所律师查验，补充核查期间，发行人股东大会、董事会及监事会

议事规则未发生变化且符合法律法规的有关规定。

（三）经本所律师查验，补充核查期间，发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署合法、有效。

（四）经本所律师查验，补充核查期间，发行人股东大会对公司董事会的历次授权或重大决策行为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

经本所律师核查，补充核查期间，除发行人董事祁耀亮于 2021 年 12 月不再担任美芯晟科技（北京）有限公司董事之外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况未发生变化。

十六、发行人的税务

（一）发行人执行的税种、税率

根据《审计报告》并经本所律师查验，报告期内，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种和税率为：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明			
纳税主体名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
本公司	12.5%	12.5%	12.5%
上海威矽半导体科技有限公司	25%	25%	25%
厦门伟测半导体科技有限公司	已注销	25%	25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明			
无锡伟测半导体科技有限公司	25%	25%	未成立
南京伟测半导体科技有限公司	25%	未成立	未成立

经本所律师查验，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种、税率符合法律法规的规定。

（二）发行人享受的税收优惠

经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其境内子公司在报告期内享受的税收优惠未发生变化且符合法律、法规的规定。

（三）发行人享受的财政补贴

根据《审计报告》并经本所律师查验，2021 年度，发行人及其境内子公司享受的财政补贴更新如下所示：

序号	金额	项目名称	补贴依据
1	5,200,000.00	超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范〔2018〕1号）
2	4,000,000.00	关键核心芯片晶圆级系统级全生态测试能力提升改造	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范〔2018〕1号）
3	5,000,000.00	固定资产投入补贴	《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会，关于进一步推动科技创新的实施意见》（锡高管发〔2017〕40号）
4	2,053,154.34	进口设备贴息	财政部商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知（财企〔2014〕36号）及《上海市商务委关于2020年进口贴息资金申报的通知》
5	600,000.00	小巨人项目补贴	关于印发《上海市科技小巨人工程实施办法》的通知规范性文件沪科规〔2021〕12号
6	600,000.00	科技发展基金	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
7	568,500.00	政策扶持补贴	《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会，关于进一步推动科技创新的实施意见》（锡高管发〔2017〕40号）
8	250,000.00	中小企业专项补贴	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
9	95,000.00	创新业务补贴	《上海市经济信息化委市财政局关于开展2020年融资担保创新业务支持项目申

序号	金额	项目名称	补贴依据
			报工作的通知》（沪经信企〔2020〕1051号）
10	40,375.00	担保补贴	《关于延续〈浦东新区小微企业增信基金管理办法〉的通知》（浦财经〔2019〕18号）
11	27,700.00	稳岗补贴	《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划大力开展以工代训工作的通知》（锡人社发〔2020〕59号）及和《关于进一步支持企业开展以工代训工作的补充通知》（锡人社发〔2020〕75号）
12	12,000.00	岗前培训补贴	《上海市人力资源和社会保障局上海市财政局关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》（沪人社规〔2021〕4号）
13	7,500.00	专利资助款	《上海市专利资助办法（沪知局规〔2018〕1号）》
14	3,000.00	就业补贴	《省政府关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响推动经济循环畅通和稳定持续发展的若干政策措施》（苏政发〔2020〕15号）、《市委市政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策意见的通知》（锡委发〔2020〕20号）
15	2,000.00	毕业生补贴	《无锡市人民政府关于促进高校毕业生来锡就业创业的若干措施的通知》（锡政发〔2020〕12号）
16	3,300.00	其他	/

（四）发行人税务合规情况

经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其境内子公司不存在因重大税务违法行为被处以行政处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司不存在因违反环境保护方面法律法规而受到重大处罚的情形，发行人募投项目符合国家有关环境保护的要求。

（二）经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司不存在因违反质量技术监督方面法律、法规而被行政处罚的情形。

（三）经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司能够按国家有关法律法规进行安全生产，不存在因违反安全生产方面的法律法规而被主管应急管理部门给予行政处罚的情形。

（四）经本所律师查验，补充核查期间，发行人不存在因劳动人事、社会保险、住房公积金等相关事项受到有关部门处罚的情形。

十八、发行人募集资金的运用

本所律师已在《法律意见书》、《律师工作报告》中详细披露了发行人募集资金的运用情况。根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人募集资金的运用情况未发生变化。

十九、发行人业务发展目标

本所律师已在《法律意见书》、《律师工作报告》中详细披露了发行人的业务发展目标，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的业务发展目标未发生变化。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

（二）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人持股 5% 以上股份的股东、控股股东不涉及其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

（三）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情况。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师已审阅《招股说明书（申报稿）》，特别对发行人引用本补充法律

意见书及《律师工作报告》相关内容已认真审阅，《招股说明书（申报稿）》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

二十二、发行人律师认为需要说明的其他问题

（一）发行人历史沿革中的代持事项

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人的代持相关事宜，截至本补充法律意见书出具之日，发行人历史上存在的所有代持均已解除。发行人股东持有的发行人股份权属清晰，不存在代持等未披露的股份安排，亦不存在权属纠纷及潜在纠纷。

（二）发行人员工持股计划

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人的员工持股计划相关事宜，补充核查期间，发行人的员工持股计划相关情况未发生变化。

（三）对赌协议

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人对赌协议的相关事宜，补充核查期间，发行人的对赌协议相关情况未发生变化。

（四）劳务外包

经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司新增一家合作的劳务公司，发行人子公司南京伟测将测试过程中部分辅助性工作如物料搬运、物料收货、成品打包、条形码扫描等工作外包给劳务公司，该劳务公司基本情况如下所示：

序号	公司名称	统一社会信用代码	经营范围
1	江苏天为 人力资源 有限公司	91320105MA1NGKWD 14	人力资源信息咨询；劳务派遣；园林绿化工程、建筑工程、室内外装饰工程设计、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；公关礼仪服务；创意策划服务；企业管理咨询服务；职业中介服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；电子产品及零配件、塑胶制品、机械零配件、汽车零配件加工、销售；搬运、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经本所律师查验，截至报告期末，为发行人及其子公司提供劳务外包服务

的公司为独立经营主体，未因向发行人提供劳务外包服务而涉及违法违规行为，且劳务外包公司与发行人不存在任何关联关系。

（五）信息豁免披露

经本所律师查验发行人相关内控管理制度及签订的《保密协议》，发行人已建立完善的内控管理制度并得到有效执行，发行人申请信息豁免披露事项具有合理的商业诉求，如披露将导致发行人违约。发行人的董事长已在豁免申请文件中签字确认，豁免披露的信息尚未泄漏。截至本补充法律意见书出具之日，公司的信息披露方式对投资者判断公司价值不存在重大影响。

二十三、结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，发行人符合《证券法》《公司法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》等有关法律法规中有关公司首次公开发行股票并在科创板上市的条件，其股票公开发行并于上交所科创板上市不存在法律障碍；发行人《招股说明书（申报稿）》所引用的本补充法律意见书和《律师工作报告》的内容适当；发行人本次发行上市已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需取得上交所的审核同意并经中国证监会同意注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

第二部分 关于《第一轮问询函》相关回复的更新

问题 2.关于核心技术来源

2.1 根据招股说明书，1) 公司 2016 年成立后即进入晶圆测试领域，2017 年实现盈利，2019 年末开拓了芯片测试业务。发行人的核心技术系自主开发，并随着测试经验的积累逐步完善。2) 截至本招股说明书签署日，公司及其子公司取得 24 项专利、1 项软件著作权，其中有 6 项发明专利，18 项实用新型专利。3) 公司有 4 名核心技术人员，就职前曾在日月光封测、长电科技等同行业公司任职，其中一名核心技术人员于 2020 年 2 月入职。另根据申报材料，部分专利发明人目前已离职。

请发行人说明：

(1) 公司 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况，是否为公司员工，该 6 项发明专利在发行人主营业务中的具体应用情况；

(2) 结合核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历，说明其在技术形成过程中发挥的作用，并结合行业研发周期、客户认证周期、测试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规；

(3) 结合核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历，说明该等人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构和发行人律师进行核查，完善核查方式，说明核查过程并发表明确意见。

回复：

一、公司 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况，是否为公司员工，该 6 项发明专利在发行人主营业务中的具体应用情况

发行人 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况及在发行人主营业务中的具体应用情况如下表所示：

序号	专利名称	申请号/专利号	技术来源	发明人	是否公司员工	具体应用
1	晶圆区域性问题的分析系统及方法	202110310750.9	自主研发	杨恭乾、路峰、高大会、闻国涛、骈文胜	皆是	1、是一种对测试环节的数据进行大量数据分析以发现异常和测试环节的问题，并对测试问题的根本原因进行智能判断的一套分析系统。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
2	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法	202110248636.8	自主研发	傅郁晓、吴庆、陈迎涛、杨栓、张丽霞	皆是	1、大规模测试服务中保险丝熔断工艺较为普遍，该发明是用一种简单的替代方法在保证质量的同时达成熔断工艺。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务与芯片成品测试业务。
3	一种测试机匹配检测系统及其方法	202011533224.0	自主研发	傅郁晓、吴庆、骈文胜、闻国涛、杨恭乾	皆是	1、是一种软件系统，主要用于测试机对设计公司提供产品进行自动适应性配置。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试与芯片成品测试业务。
4	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统	202011523844.6	自主研发	骈文胜、傅郁晓	皆是	1、在大规模测试服务中确保每个芯片被正确识别和跟踪，并可以持续保证最高的测试质量；当遇有多流程的情况时不会出现测试错误，是大规模测试服务中质量管理系统的关键环节。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
5	一种多平台联动提效机构	202011489734.2	自主研发	杨栓、关姜维、刘栋栋	皆是	1、将两个测试机对接到一个探针台上，可以在保证测试质量的同时提高测试效率和设备利用率。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
6	一种集成电路精确测试小电阻的方法	202011160294.6	自主研发	左上勇、袁常乐、王敏	皆是	1、属于一种测试的优化方法，在保证高精度的同时，运用简单仪器测试小电阻。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试与芯片成品测试业务。

如上表所示，上述 6 项发明专利均由发行人员工自主研发形成并应用于主营业务。

二、结合核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历，说明其在技术形成过程中发挥的作用，并结合行业研发周期、客户认证周期、测

试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规。

1、发行人核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历及其在技术形成过程中发挥的作用

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	本科学历，电子精密机械专业。1993年-2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司设备经理；2000年-2004年任职于威宇科技测试封装（上海）有限公司；2004年-2009年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试厂长、封装厂长、资材处长；2009年-2016年任职于江苏长电科技股份有限公司，任事业中心总经理、集团海外销售副总裁；2016年11月至今任公司董事长、总经理。	1、基于 ARM 架构的高性能处理器的测试解决方案 2、晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术 3、晶圆测试良率分析和优选管控技术 4、基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案 5、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、项目统筹规划； 2、参与制定产品测试量产的规范并设计量产的流程和相应的管控机制； 3、技术规范评估。 1、项目统筹规划； 2、参与晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的方案设计和相应的验收标准的制定。 1、项目统筹规划； 2、参与设计测试良率分析架构体系和设备自动优选的方案核心代码分解。 1、项目统筹规划； 2、参与研究网络安全芯片测试的核心难点，为解决方案提供技术路线。 1、项目统筹规划； 2、参与铂金针测试良率与针痕管控的方案设计。
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	本科学历，机械设计及其自动化专业。2001年-2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司设备工程师；2004年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、经理、封装厂长、测试厂长；2016年5月至今任公司董事、副总经理。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案 2、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置 3、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案 4、测试机配置匹配提效技术 5、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、项目可行性分析，落实专案前期立项工作 2、比对、分析、定制、优化技术方案； 3、制定验收标准及检验阶段性目标。 1、项目统筹规划； 2、参与稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极方案。 1、项目统筹规划； 2、参与研究测试的核心难点，为解决方案提供技术路线。 1、项目统筹规划； 2、参与调研设计测试机配置匹配规则； 3、参与测试机配置匹配流程的设计以及流程图的规划设计； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。 1、项目可行性分析，落实专案前期立项工作；

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	本科学历，电子工程专业。1993-2000 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司 IT 自动化经理；2000 年-2004 年任威宇科技测试封装（上海）有限公司 IT 部门经理；2004 年-2006 年任日月光封装测试（上海）有限公司 IT 部门经理；2006 年-2018 年任职于晟碟半导体（上海）有限公司，历任 IT 部门经理、总监；2018 年 5 月至今任公司董事、副总经理。	1、晶圆测试良率分析和优选管控技术	2、参与研究铂金探针的应用和整形的核心难点，为解决方案确定技术路线。
				2、基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与创建测试良率分析建模方案； 3、参与设计测试良率分析架构体系、设备优选数学模型； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
4	刘琨	核心技术人员	本科学历，检测技术及仪器专业。1997 年-2001 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司产品工程师；2001 年-2004 年任职威宇科技测试封装（上海）有限公司，历任高级产品工程师、产品工程主管；2004 年-2005 年任英特尔（上海）有限公司工程主管；2005 年-2009 年任泰瑞达（上海）有限公司应用工程经理，负责中国北方区域；2009 年-2015 年任北京汉迪龙科科技有限公司副总经理；2015 年-2020 年任上海旻艾半导体有限公司总经理；2020 年 2 月至今，担任公司副总经理。	1、薄片晶圆测试技术	1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与薄片晶圆测试技术路线设计； 3、参与薄片晶圆治具设计和工艺开发； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
				2、可选择性导片装置	1、项目统筹规划； 2、负责可选择性导片材质选择和确定； 3、参与规划设计可选择性导片电路及与测试机的配合机制； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
5	左上勇	专利发明人	本科学历，材料化学专业。2010 年-2019 年任职于日月光封装测试有限公司，历任测试设备工程师、测试开发工程师、开发主任工程师；2010 年-2019 年任职于上海月芯半导体科技有限责任公司，任开发主任工程师；2019 年 6 月至今任公司研发中心总监。	1、5G 通信射频前端晶圆测试解决方案	1、研究 5G 通信射频前端通用测试参数并进行晶圆可测性设计； 2、制定使用低频参数测试加数据仿真反馈产品射频性能的技术方案。
6	杨恭乾	专利发明人	本科学历，信息与计算科学专业。2009 年-2013 年任职中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，历任 IT 测试部工程师，部门主管；2013 年-2018 年任职菲	1、测试机配置匹配提效技术	1、调研设计测试机配置匹配规则； 2、进行测试机配置匹配流程设计以及流程图的规划设计； 3、设计测试机配置匹配软件核心

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
7	傅郁晓	专利发明人	尼萨光电通讯(上海)有限公司, 历任高级工程师, IT 测试部经理, 高级经理; 2018 年 2 月至今任公司研发中心总监。		架构及进行功能模块分解开发。
				2、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、创建测试良率分析建模方案; 2、设计测试良率分析架构体系、设备优选数学模型; 3、设备自动优选方案核心代码的分解、开发与调试。
				3、基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、研究网络安全芯片测试的核心难点并针对性提出解决方案; 2、网络安全芯片软硬件测试方案的设计、开发和调试。
			本科学历, 微电子专业。2007 年-2016 年任日月光封装测试(上海)有限公司测试设备主管; 2016 年 5 月-2020 年 7 月任上海伟测半导体科技有限公司研发中心经理; 2020 年 7 月至今任公司销售总监。	1、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、进行高速高分辨率电流型数模转换器实际测试数据和理论数据的修调和数据校准处理; 2、对实际测试数据和测试结果进行稳定分析, 并参与测试方案的验收。
				2、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、参与晶圆测试中对位过程的分析 and 总结, 制作对位动作流程图并分析其必要性和优化空间; 2、设计一种新型可以提高打点产品效率的模具, 以替代原有设备在对产品外围需要打四到五圈墨点的方案。
				3、WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案	1、追踪 WIFI6 技术规范, 进行相关数据收集整理, 设计公司 WIFI6 通用测试规范以及相应的测试规格书; 2、根据行业标准和 WIFI6 通用测试规范制定项目验收标准。
				4、自动降温装置	1、参与研发自动降温装置。
				5、延长墨管使用寿命的装置	1、设计实验方法以及设计打点器的机械装置。
				6、测试机配置匹配提效技术	1、测试机配置匹配需求分析和应用验证。
				7、晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术	1、晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的方案设计和相应验收标准的制定; 2、设计实验进行晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的验证, 并进行风险分析。
				8、基于 ARM 架构的高性能处理器的测试解决方案	1、参与 ARM 架构的高性能处理器的测试项目规划、选定标的产品规范和设计测试硬件, 并进行测试程序的开发和设计; 2、制定产品测试量产的规范并设计量产的流程和相应的管控机制;

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					3、执行工程验证和工程验收的标准，并进行测试稳定性的评估。
				9、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、追踪高性能汽车电子行业技术规范，并和相关的设计公司进行测试规格和测试流程的规划设计，相应制定公司高性能汽车电子行业通用测试规范以及相应的测试流程； 2、制定符合行业标准的高性能汽车电子行业通用项目验收标准和规范。
8	张伟军	专利发明人	本科学历，电子科学与技术专业。2016年6月至今任公司研发中心工程师、经理。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、分析并设计实验验证背银、背金晶圆高压测试不稳定的原因和失效模式； 2、设计稳压装置来保持电极电压的稳定，解决 prober chuck 电源会影响测试的问题。
				2、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、参与分析高速高分辨率电流型数模转换器测试的核心难点并提供相应的解决方案例； 2、负责高速高分辨率电流型数模转换器软件测试方案的设计，开发和调试。
				3、晶圆外观检测平台的改造装置	1、根据新型的外观检测承载平台方案设计模具并进行仿真模拟； 2、制定新型模具验证流程和验收标准。
				4、WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案	1、进行 WIFI6 无线测试的可行性分析和具体测试实现方案的构思，形成项目规划； 2、根据项目规划选定标的产品规范，设计测试硬件并进行测试程序的开发和设计。
				5、探针台自动清洁装置	1、系统分析芯片失效模式及原因； 2、基于失效芯片的数据，分析灰尘对芯片测试结果的影响； 3、参与设计、研发探针台自动清洁装置。
9	晏云飞	专利发明人	本科学历，电子信息与工程专业。2013年-2017年3月任职于京隆科技（苏州）有限公司，历任测试部门组长，代理课长；2017年3月至2018年5月任公司研发中心工程师。	1、测试机多方位使用兼容装置	1、根据方位运动控制机制和测试机需求规格设计新型测试机的空间运动机构，进行建模并设计整体构建图； 2、对新型测试机的空间运动机构进行模拟设计，并设计机构的生产制作图纸。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、分析高速数字通信芯片行业规范已经制定的技术规范，进行测试

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					试的可行性分析和具体测试实现方案的设计，形成项目规划； 2、根据项目规划选定标的产品规范设计测试硬件，并进行测试程序的开发 and 设计。
				3、探针台自动清洁装置	1、数据收集和分析，形成结案报告供项目研讨。
10	陈迎涛	专利发明人	本科学历。2007 年-2016 年历任日月光封装测试（上海）有限公司测试一厂生产组长，生产主任；2016 年 5 月至今历任上海伟测生产经理，南京伟测厂长。	1、测试机多方位使用兼容装置	1、进行新型测试机的空间运动机构的制作和安装，并评估其实际效果是否符合预期； 2、测试机多方位使用兼容装置项目的验收。
				2、探针台自动清洁装置	1、评估喷吹管，脉冲电磁阀，气包，控制仪，出气嘴的选型和功能；
				3、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、进行熔丝烧调工艺精密控制的实验验证技术的开发，制定评价标准； 2、执行熔丝烧调工艺精密控制的实验验证，对稳定性及一致性进行分析。
				4、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、根据测试方案，进行测试硬件原理图、布线图的制作以及各种治具的设计； 2、执行各类硬件的制作，并制定和执行相应的硬件验收及标准。
11	周俊	专利发明人	本科学历，机械设计及其自动化专业。2008 年-2017 年 5 月任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任设备工程师，测试设备专案工程师，主任工程师；2017 年 7 月至今历任公司上海伟测厂长、无锡伟测总经理。	1、测试机多方位使用兼容装置	1、分析现有测试机的空间运动机构，整理当前测试机无法实现全方位探测的原因，并提出具体控制模式； 2、提供需要增加的测试机方位运动控制机制并提供测试机需求规格。
				2、探针台自动清洁装置	1、设计自动清洁装置的机械图纸； 2、设计实验收集性能参数。
12	史小奇	专利发明人	专科学历，机电一体化专业。2007 年-2017 年任上海纪元微科电子有限公司测试工程师；2017 年-2020 年任上海伟测研发中心资深工程师；2020 年至今历任无锡伟测研发中心经理、研发中心副总监。	1、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、针对集成电路针测过程容易扎偏的情况提出研发针痕管控的工艺思路； 2、设计防偏结构以及图纸。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、追踪高速数字通信芯片技术规范，和设计公司进行相关数据收集，整理高速数字通信芯片通用测试规范以及相应的测试规格书； 2、根据行业标准和高速数字通信芯片通用测试规范制定项目验收标准。

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
13	张洪亮	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业。2009年-2011年任福州福顺半导体有限公司测试工程师；2011年-2015年任日月光封装测试（上海）有限公司测试设备工程师；2016年-2017年任歌尔股份有限公司测试部项目经理；2017年-2018年任公司研发中心工程师。	1、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术 2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、实验数据收集，及进行部分元器件焊接。 1、根据制定好的高速数字通信芯片测试规范，制定产品测试量产的规范，并设计量产的流程和相应的管控机制； 2、执行高速数字通信芯片工程验证和工程验收，并进行测试稳定性的评估。
14	俞磊	专利发明人	本科学历，自动化专业。2011年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任品质工程师、专案工程师；2016年9月-2020年任公司研发中心工程师；2020年至今，任无锡伟测研发中心经理。	1、晶圆测试中对位辅助调整装置 2、晶圆外观检测平台的改造装置 3、WIFI6无线网络通讯芯片测试解决方案 4、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术 5、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、根据设计图纸进行新型模具的制作并根据验证流程进行验证； 2、根据验收标准，执行新型模具的验收，评估实际效果。 1、根据外观检测承载平台设计图纸进行新型模具的制作，并根据验证流程进行验证； 2、根据验收标准，执行外观检测承载平台模具的验收，并评估实际效果。 1、根据测试硬件设计图纸，进行测试硬件的制作并制定测试硬件的验收规范； 2、执行测试硬件的验收并评估硬件性能的评估。 1、设计测试管控工艺监控报警机制； 2、负责载板、导向套管、触杆和触控开关的选型。 1、根据测试硬件设计图纸，对高速数字通信芯片进行测试硬件的制作并制定测试硬件的验收规范； 2、执行高速数字通信芯片测试硬件的验收并评估硬件性能的评估。
15	崔勇彬	专利发明人	本科学历。2016年至今历任公司生产组长、生产主任、生产经理。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置 2、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案 3、自动降温装置 4、延长墨管使用寿命的装置	1、设计试验对当只有一个测试电极电压触点且离电压触点远时测试电压逐渐衰减情况的验证。 1、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆DOE测试的验证设计和操作； 2、测试流程设计和良率管控规则的制定。 1、分析降温装置的降温媒介以及在prober上使用的便捷性； 2、设计降温装置的机械图纸。 1、分析油墨干涩的原因； 2、设计新的油墨打点器，增强油

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					墨的流动性从而使提高油墨利用率。
16	关姜维	专利发明人	本科学历，电子信息科学与技术专业。2010年-2016年历任日月光封装测试（上海）有限公司工程师，工程主管；2016年6月至今任公司研发中心经理、总监。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、高清图像传感器芯片晶圆主流测试方案的分析并提出通用化的设计方案； 2、设计通用性高、可程序控制、可执行校准的通用性光源解决方案； 3、设计通用性高模块化的程序架构方案。
				2、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、根据新型模具的设计方案产生模具设计图纸并进行仿真模拟； 2、设计和制定新型模具验证流程和验收标准。
				3、晶圆外观检测平台的改造装置	1、分析现有晶圆外观检测平台机构并分析现有平台的承载平台的运动和控制机制的优缺点； 2、提出新型的一种真空吸附检测台的外观检测平台承载平台的运动和控制机制并分析可行性和风险管控机制。
				4、WIFI6无线网络通讯芯片测试解决方案	1、根据制定好的测试规范制定产品测试量产的规范，并设计量产的流程和相应的管控机制； 2、执行工程验证和工程验收的规范，并进行测试稳定性的评估。
				5、自动降温装置	1、设计实验步骤以及方法，评估不同媒介的降温效率；
				6、多平台联动提效技术	1、为提升测试机的使用效率，立项研发多平台联动机构； 2、设计信息采集模块。
				7、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、参与技术规格的制定以及机台参数的选定； 2、设计并验证铂金探针整形后良率监控技术方案。
17	赵阿勇	专利发明人	专科学历。2016年-2018年8月任公司研发中心工程师。	1、自动降温装置	1、收集不同媒介的降温时间，汇总实验数据。
				2、延长墨管使用寿命的装置	1、收集不同规格油墨连续打点不干涩的数据并整理分析实验数据。
18	吉晋阳	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业。2009年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、主任；2016年6月至今任公司研发中心经理、总监。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、负责通用高清图像传感器芯片晶圆测试通用探针卡的设计并评估探针卡对光路的影响； 2、负责通用性高模块化的程序架构的程序的开发和调试。
				2、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、负责稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极的方案设计；

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					2、提供多种连接与测试电极的方案，并安排 DOE 方案验证。
				3、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、参与分析高速高分辨率电流型数模转换器测试的硬件难点并提供相应的解决方案； 2、负责高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试使用的硬件-屏蔽针卡的设计、制作和性能评估。
19	柴振极	专利发明人	本科学历。2016 年 7 月至今担任研发中心技术员、工程师。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、根据稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极方案和 DOE 方案，进行实验硬件的制作并进行设备的安装。
20	李峰	专利发明人	本科学历，电力系统及其自动化专业。2005 年-2007 年 1 月，在日月光封装测试（上海）有限公司担任厂务经理；2007 年-2016 年任上海峰越机电设备安装有限公司经理；2016 年至今，任公司厂务。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、执行通用性光源和模块化的程序采集实验数据，并进行稳定性和准确性分析； 2、培训研发中心工程师光模块使用方法。
21	吴庆	专利发明人	本科学历，电子工程专业。2007 年-2015 年任职于晟碟半导体有限公司，历任设备组长，测试设备工程师；2015 年-2017 年任职于丽恒光微半导体，历任设备工程师，设备经理；2017 年 6 月至今任公司研发中心经理。	1、测试机配置匹配提效技术	1、测试机配置匹配代码撰写和调试。
				2、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、根据熔丝烧调工艺精密控制的实现方案提出具体的实施方式，并进行相应的外围电路设计； 2、对外围电路的设计进行制作，并对硬件进行相应的验收。
				3、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、根据标的产品的测试方案和硬件设计，执行具体测试项目的开发和调试，并执行相应的产品特性分析； 2、制定相应的测试项目开发的验收标准，并按照标准进行数据分析处理。
22	杨栓	专利发明人	本科学历。2013 年-2014 年上海樊境智能科技责任有限公司任销售经理；2014 年-2019 年任上海旻艾半导体有限公司测试工程师；2019 年 12 月至今任公司研发中心工程师。	1、多平台联动提效技术	1、设计技术图纸并制作样品； 2、分析待测晶圆的移动路径，模拟测试过程对移动次数进行计算。
				2、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、分析传统熔丝烧调工艺技术的实现方式，分析测试良率、稳定性以及研究传统技术是否可以满足未来的严格测试要求，如汽车电子和工业电子的严苛需求； 2、提出新型电子运用如汽车电子和工业电子对测试中熔丝烧调工艺的需求，并设计熔丝烧调工艺精密控制的实现方案及验收标准。
				3、高性能汽车电子芯片	1、分析汽车电子产品的通用特

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
				测试解决方案	点，根据汽车电子产品的测试开发特性选取和整理测试要求及测试规范； 2、根据标的产品的测试规范，制定相应的测试方案和根据产品制定相应的验收标准。
23	张丽霞	专利发明人	本科学历。2018年3月至今任公司研发中心工程师。	1、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、执行熔丝烧调工艺精密控制工艺化验证和DOE方案的设计； 2、执行熔丝烧调工艺精密控制技术的项目验收和工艺稳定分析。
				2、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、执行标的产品验证和数据分析确实测试的稳定性和数据的一致性； 2、设计DOE方案的设计和执行业并进行风险的评估。
24	刘栋栋	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业，2013年-2018年年任矽品科技（苏州）有限公司测试产品工程师；2018年-2021年3月任公司研发中心工程师；2021年3月至今任无锡伟测研发中心经理。	1、多平台联动提效技术	1、设计控制系统包括信号配置单元、路径规划单元等； 2、进行多平台联动通讯驱动开发和GPIO信号调试。
25	袁常乐	专利发明人	本科学历，物理系电子信息科学与技术专业。2019年至今任公司研发中心工程师。	1、5G通信射频前端晶圆测试解决方案	1、执行测试硬件的设计、测试软件的开发和调试； 2、对测试结果和实验室测试结果进行一致性分析并优化测试算法。
26	王敏	专利发明人	本科学历，功能材料专业。2017年-2019年任日月光封装测试有限公司工程部产品测试工程师；2019年7月至2021年7月任公司研发中心工程师。	1、5G通信射频前端晶圆测试解决方案	1、设计验收规则和数据分析规则； 2、设计DOE验证的实验以及执行DOE的实验验证工作。
27	高大会	专利发明人	专科学历，电工电子专业。2002年-2004年任职于飞利浦光磁电子（上海）有限公司，任生产领班；2007年-2015年任职于日月光封装测试有限公司，历任储备组长，组长 生产管理师，主任；2015年2月-2015年9月任职于环维电子（上海）有限公司，任组长；2015年9月-2016年11月任职于环旭电子股份有限公司，历任组长，课长；2016年12月至今任公司生产经理。	1、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、进行自动优选方案验证和数据分析，并提供优化需求； 2、对自动优选方案进行验收和接收。
				2、基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、进行网络安全芯片晶圆测试方案的实际测试稳定性分析，并和测试结果进行一致性分析； 2、进行网络安全芯片晶圆测试方案测试效率分析。
28	赵坤鹏	专利发明人	本科学历，机电一体化工程专业。2011年-2019年任日月光封装测试封装（上海）有限公司设备工程师；2019年-2020年任无锡华润微电子有限公司测试厂	1、测试方案开发的系统验证板	1、参与系统验证板的需求分析； 2、参与系统验证板原理图设计以及PCB layout出图； 3、制定参数验收标准。
				2、延长墨管使用寿命的	1、核对实验数据并提交报告给项

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
			设备主管；2020 年 4 月至今担任无锡伟测研发中心经理。	装置	目组审核；
				3、低温测试工艺结霜控制技术	1、低温测试过程中测试硬件上产生冷凝结霜原因分析； 2、参与研发项目可行性分析以及方案制定； 3、设计解决料盘翘曲的压盘结构的技术方案； 4、机械装置图纸设计。
				4、32 位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	1、对通用型硬件重新设计和优化； 2、电路板原理图设计以及 PCB layout 出图； 3、自动开发软件代码的撰写并完善测试标准库。
				5、修调卡及线缆快速验证装置	1、线缆异常信息分类分析； 2、设计快速验证装置图纸并协调生产制作。
				6、测试机配置匹配提效技术	1、分析无法及时检测集成电路产品从分选机上掉落或者没有吸起的原因； 2、设计改善方案和装置图纸。
				7、自动降温装置	1、设计常高温快速切换的方案； 2、评估各种技术方案降温的时间以及成本。
				8、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计防呆装置的结构； 2、确定防尘盖的评估选型； 3、对加工卡槽的密封性进行优化。
				1、测试方案开发的系统验证板	1、系统验证板样品生产进度协调； 2、收集实验数据以及提交报告给项目组审核。
				2、低温测试工艺结霜控制技术	1、追踪方案验证实施结果以及实验数据收集； 2、对应用技术后的测试结果进行验证； 3、分析效率提升部分数据并提交报告； 4、参与验证装置的报警信息分类调试； 5、装置试验数据确认以及提交报告。
				3、32 位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	1、参与研发中心测试程序的自动化生成方法的设计； 2、电路板验收以及提交报告。
29	杨征	专利发明人	专科学历，机械制造与自动化专业。2010 年-2020 年任日月光封装测试（昆山）有限公司设备主管；2020 年 9 月-2021 年 5 月任无锡伟测研发中心经理。	4、修调卡及线缆快速验证装置	1、参与验证装置的异常信息分类归纳；

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					2、参与验收装置数据以及提交报告。
				5、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计装置下单制作及交期追踪； 2、实验数据收集以及报告整理提交。
				6、试机配置匹配提效技术	1、参与验收装置数据以及提交报告。
				7、自动降温装置	1、降温装置机械图纸设计和加工制作； 2、实验数据收集以及报告整理。
30	张秀超	专利发明人	本科学历，物流管理专业。2013-2014 年任日月光封装测试（上海）有限公司 QA LAB 工程师；2017 年 2 月至今任公司研发中心工程师。	1、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计并验证探针卡延长寿命方案； 2、设计探针台增加组合清针方案； 3、试验并确定失效验证分析方法。
31	赵怀菊	专利发明人	专科学历，电子商务专业。2014 年 1 月-2015 年 5 月，任欣阳精密模具（上海）有限公司质量工程师；2018 年 1 月至今任公司研发中心工程师。	1、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计并验证探针卡低温封孔解决方案； 2、设计并验证探针卡抗干扰处理方案； 3、试验并确定快速有效验证探针卡异常方法。

截至本补充法律意见书出具之日，上述核心技术人员与专利发明人中，晏云飞、赵阿勇、张洪亮、王敏、杨征等 5 人已离职，其余人员均尚在公司任职。

2、结合行业研发周期、客户认证周期、测试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规

（1）行业研发周期

经本所律师核查，行业缺乏研发周期的相关统计数据，同行业上市公司和公开渠道亦未披露相关数据。报告期内发行人各类测试核心技术的研发周期一般在 5-18 个月之间。

（2）客户认证周期和测试方案开发和验证周期的一般情况

在客户认证周期方面，公司成为客户的合格供应商的认证过程一般包括双方初步接洽、签署保密协议、客户来厂参观及验厂、公司通过合格供应商认证等几个环节，整个认证周期一般在 30 天至 90 天之间。发行人针对某特定产品进行测试

方案开发和验证的周期一般为1-3个月左右。

（3）公司主营业务发展过程

公司自设立以来，一直专注于经营集成电路测试服务业务。公司成立以来，主营业务的发展情况如下：

A. 2016年-2017年公司处于创业摸索和积累阶段，主要提供晶圆测试服务

公司成立之初，选择了技术含量高、市场竞争格局好的“晶圆测试”业务，在工厂选址上，选择毗邻中国最大的集成电路产业集群上海张江。在业务方面，公司得到了以晶丰明源、艾为电子等为代表的模拟类客户的认可，并开始逐步导入中高端测试平台及客户，拓展数字类的客户和测试服务。

B. 2018年-2019年公司进入快速成长阶段，并开始介入芯片成品测试业务

在该期间，公司不断完善整套测试作业体系，加强测试技术和测试工艺的研发投入，大力引进中高端测试平台，不断提升公司的高端测试服务能力。2019年末，鉴于公司在晶圆测试积累的客户基础以及行业口碑，公司又适时开拓芯片成品测试业务，为公司的发展创造了新的增长点。

C. 2020年至今，公司开始确立行业领先地位，确定了以“以晶圆测试为核心，积极发展中高端芯片成品测试”的差异化竞争策略

“高端化、顶尖客户、全力扩产”是这一阶段的公司发展策略，公司抓住“美国打压中国半导体行业，中国大陆的一线芯片设计公司加快测试服务供应商的国产化替代”的历史契机，一方面加大研发投入，重点突破6nm-14nm先进制程芯片、5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性能计算芯片、FPGA芯片、复杂SoC芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，另一方面快速扩充高端测试产能，使得公司具备承接中国大陆高端芯片设计公司测试订单的技术实力和产能规模。

（4）公司核心技术形成的关键历史节点

截至本补充法律意见书出具之日，公司拥有的核心技术形成的关键历史节点情况如下：

序号	核心技术大类	技术形成的关键历史节点		
		时间节点	形成的核心技术	应用范围
1	测试方案开发技术	2016 年-2017 年	高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	数模转换芯片
			高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	图像传感芯片
		2018 年-2019 年	高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	数据通信芯片
			WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案	无线网络芯片
			第 3 代快闪存储器 IP 的晶圆测试方案	存储器芯片
			基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	安全芯片
			现场可编程逻辑门阵列芯片测试解决方案	FPGA 芯片
		2020 年以后	5G 通信射频前端晶圆测试解决方案	5G 射频前端芯片
			基于 ARM 架构的高性能处理器的测试解决方案	处理器芯片
			高性能汽车电子芯片测试解决方案	汽车芯片
			高性能区块链算力芯片晶圆测试方案	AI、区块链芯片
			32 位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	微控制器芯片
2	测试工艺难点突破与精益测试提效技术	2016 年-2017 年	晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	晶圆测试
		2018 年-2019 年	测试机配置匹配提效技术	晶圆测试、芯片成品测试
			晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术	晶圆测试
			低温测试工艺结霜控制技术	晶圆测试、芯片成品测试
		2020 年以后	芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	芯片成品测试
			晶圆测试良率分析和优选管控技术	晶圆测试
			薄片晶圆测试技术	晶圆测试
			多平台联动提效技术	晶圆测试
3	设备改造升级技术	2016 年-2017 年	测试机多方位使用兼容装置	晶圆测试、芯片成品测试
			解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	晶圆测试
			晶圆测试机抗干扰外壳装置	晶圆测试
		2018 年-2019 年	探针台自动清洁装置	晶圆测试
			晶圆外观检测平台的改造装置	晶圆测试
		2020 年以后	晶圆测试机抗干扰外壳装置	晶圆测试
4	测试治具设计技术	2016 年-2017 年	延长墨管使用寿命的装置	晶圆测试
			晶圆测试中对位辅助调整装置	晶圆测试

序号	核心技术大类	技术形成的关键历史节点		
		时间节点	形成的核心技术	应用范围
		2018 年-2019 年	自动降温装置	晶圆测试
			测试方案开发的系统验证板	晶圆测试、芯片成品测试
		2020 年以后	修调卡及线缆快速验证装置	晶圆测试、芯片成品测试
			可选择性导片装置	晶圆测试
			晶圆测试探针卡精密管控技术	晶圆测试
		5	自动化测试及数据分析技术	2018 年-2019 年
测试参数大数据多维度统计分析系统	数据分析系统			
生产稼动率统计分析和管控系统	数据分析系统			
数据挖掘与多维度分析系统	数据分析系统			
2020 年以后	Mapping 分析系统			数据分析系统

（5）技术来源及其合法合规性

公司是由骈文胜、闻国涛等几位在集成电路封测行业具有丰富从业经验的资深人士于 2016 年创立。公司设立时就对标国内一流和国际领先的测试企业，通过自主研发，不断攻克测试技术难点，提升服务水平和服务能力，立志通过技术驱动打造一家具有核心竞争力的独立第三方专业测试服务商。创立以来，公司高度重视技术研发，不断加大研发投入，通过自主研发和技术积累逐步形成了公司在测试方案开发、设备改造升级技术、测试治具设计、测试自动化和智能化等方面的核心技术。发行人主要技术均来源于自主研发，且拥有自主知识产权，不存在合作开发、委托开发的情形。截至本补充法律意见书出具之日，公司已经取得 29 项专利，其中有 7 项发明专利。公司核心技术的来源合法合规，均为自主研发，不存在来源于其他任何无关第三方。发行人现有专利、核心技术等无形资产不存在侵犯知识产权、商业秘密的情形，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷。

三、结合核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历，说明该等人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历详见本补充法

律意见书“第二部分/问题 2./二/1、发行人核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历及其在技术形成过程中发挥的作用”。

1、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）是否存在违反原任职单位关于竞业禁止的情形

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的劳动合同、与原任职单位有交易的银行卡流水、原任职单位出具的说明等资料并经本所律师访谈核心技术人员和专利发明人，公司核心技术人员和专利发明人与原任职单位是否签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同以及是否获得竞业禁止补偿金等情况如下表所示：

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	否	否	否	1、未签订竞业禁止协议，离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反竞业禁止方面的纠纷、诉讼或仲裁； 3、原单位长电科技与公司一直保持良好的合作关系，且 2018 年和 2019 年长电科技均为公司的第一大客户；
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	否	否	否	未签订竞业禁止协议且原任职单位出具其不负竞业禁止义务的说明
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	是	否	否	1、离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位直属领导接受了访谈，证明其不存在违反

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
						竞业禁止方面的纠纷、诉讼或仲裁； 3、原单位晟碟半导体从事存储器业务，与公司的业务不存在直接竞争关系；
4	刘琨	核心技术人员	否	否	否	未签订竞业禁止协议且原任职单位出具其不负竞业禁止义务的说明
5	左上勇	专利发明人	否	否	否	
6	杨恭乾	专利发明人	是	否	否	1、离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位菲尼萨从事光通信业务，与公司的业务不存在直接竞争关系
7	傅郁晓	专利发明人	否	否	否	
8	张伟军	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
9	晏云飞	专利发明人	否	否	否	
10	陈迎涛	专利发明人	否	否	否	
11	周俊	专利发明人	否	否	否	
12	史小奇	专利发明人	否	否	否	
13	张洪亮	专利发明人	否	否	否	
14	俞磊	专利发明人	否	否	否	
15	崔勇彬	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	不适用	
16	关姜维	专利发明人	否	否	否	
17	赵阿勇	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
18	吉晋阳	专利发明人	否	否	否	
19	柴振极	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
20	李峰	专利发明人	否	否	不适用	原任职单位系其

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
						本人设立的公司
21	吴庆	专利发明人	否	否	否	
22	杨栓	专利发明人	否	否	否	
23	张丽霞	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	不适用	
24	刘栋栋	专利发明人	否	否	否	
25	袁常乐	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
26	王敏	专利发明人	否	否	否	
27	高大会	专利发明人	否	否	否	
28	赵坤鹏	专利发明人	否	否	否	
29	杨征	专利发明人	否	否	否	
30	张秀超	专利发明人	否	否	否	
31	赵怀菊	专利发明人	否	否	否	

如上表所示，公司核心技术人员和专利发明人中仅路峰、杨恭乾 2 人与原任职单位签订过竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同，由于其未收到过竞业禁止补偿金，因此不负竞业禁止的义务。其余人员因未签署过竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同，并且未收到过竞业禁止补偿金，因此亦不负竞业禁止的义务。

2、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）是否存在违反原任职单位关于保密协议约定的情形

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的劳动合同、保密协议等资料并经本所律师访谈核心技术人员和专利发明人，公司核心技术人员、专利发明人与原任职单位是否签订保密协议或含保密条款的劳动合同以及是否违反保密约定等情况如下表所示：

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订保密协议或含保密条款的劳动合同	是否违反保密约定	备注
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	是	否	原单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反保密约定方面的纠纷、诉讼或仲裁

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订 保密协议或含保密条款 的劳动合同	是否违反保 密约定	备注
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明 人	是	否	原任职单位出具其未 违反保密义务的说明
3	路峰	核心技术人员、专利发明 人	是	否	原任职单位直属领导 接受访谈，证明其不存 在违反保密约定方面 的纠纷、诉讼或仲裁
4	刘琨	核心技术人员	是	否	原任职单位出具其未 违反保密义务的说明
5	左上勇	专利发明人	是	否	
6	杨恭乾	专利发明人	是	否	
7	傅郁晓	专利发明人	是	否	
8	张伟军	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
9	晏云飞	专利发明人	是	否	
10	陈迎涛	专利发明人	是	否	
11	周俊	专利发明人	是	否	
12	史小奇	专利发明人	是	否	
13	张洪亮	专利发明人	是	否	
14	俞磊	专利发明人	是	否	
15	崔勇彬	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	
16	关姜维	专利发明人	是	否	
17	赵阿勇	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
18	吉晋阳	专利发明人	是	否	
19	柴振极	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
20	李峰	专利发明人	否	不适用	原任职单位系其本人 设立的公司
21	吴庆	专利发明人	是	否	
22	杨栓	专利发明人	是	否	
23	张丽霞	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	
24	刘栋栋	专利发明人	是	否	
25	袁常乐	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
26	王敏	专利发明人	是	否	
27	高大会	专利发明人	是	否	
28	赵坤鹏	专利发明人	是	否	
29	杨征	专利发明人	是	否	

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订 保密协议或含保密条款 的劳动合同	是否违反保 密约定	备注
30	张秀超	专利发明人	是	否	
31	赵怀菊	专利发明人	否	否	

如上表所示，公司核心技术人员、专利发明人中有 23 人与原任职单位签订了保密协议或包含保密条款的劳动合同。经本所律师访谈上述人员并对其进行网络核查，上述人员未违反保密约定且与原任职单位不存在诉讼、仲裁或其他纠纷。

3、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）与原单位是否存在纠纷或潜在纠纷

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的相关资料并经本所律师访谈、网络核查，公司核心技术人员和专利发明人与原任职单位不存在任何与竞业禁止义务、保密义务或知识产权相关的诉讼或仲裁，公司核心技术人员、专利发明人与原任职单位不存在纠纷或潜在纠纷。

四、核查过程

1、查阅发行人拥有的专利证书，并获取国家知识产权局出具的专利批量法律状态证明；

2、查阅发行人出具的 6 项发明专利在主营业务中具体应用情况的说明；

3、查阅核心技术人员、专利发明人与原任职单位的劳动合同或同时期劳动合同模板、保密协议（如有）、竞业禁止协议（如有）；

4、访谈骈文胜、路峰原任职单位的直属领导，查阅闻国涛、刘琨原任职单位出具的说明；

5、查阅发行人出具的说明，了解核心技术人员、其他专利发明人的从业经历、参与的专利发明情况、核心技术形成过程中发挥的作用以及核心技术形成的历史节点等；

6、访谈核心技术人员与专利发明人，了解其与原任职单位关于是否签订竞业禁止或竞业限制、保密义务相关协议以及是否收到原任职单位的竞业禁止补偿金等情况；

7、取得并查阅核心技术人员、在职的其他专利发明人与原任职单位有交易的银行卡流水；

8、通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开网站对发行人专利、核心技术人员及专利发明人是否存在纠纷的情况进行网络核查。

五、核查意见

经核查，本所律师认为：

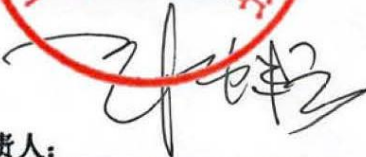
1、公司 6 项发明专利均为公司自主研发，专利发明人均为公司员工，该 6 项发明专利均运用于发行人主营业务；

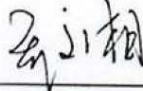
2、公司核心技术来源均为公司自主研发，合法合规；

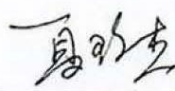
3、公司核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

（本页以下无正文）

(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书(二)》之签署页)


上海市锦天城律师事务所
负责人: 
顾功耘

经办律师: 
乔文湘

经办律师: 
夏瑜杰

2022 年 4 月 27 日